

コストを、徹底的に削減できる『M40 & M46』SPシリーズ

M40 & M46 SP series that enables maximum cost reduction

特長

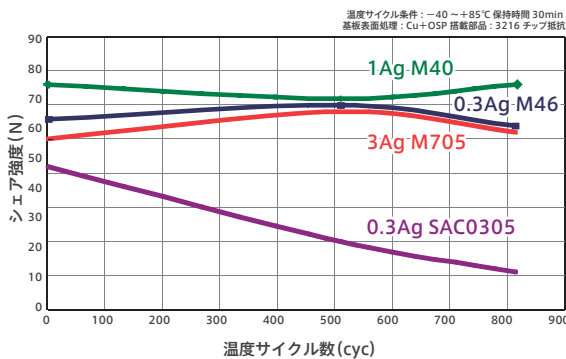
- **高品質な低銀化を達成** 高騰する貴金属の使用を抑え、M705同等以上の品質特性を達成
- **プロファイルの変更が不要** 融点の低温化技術でM705と同一条件実装を実現、大幅な生産コストを削減
- **高速印刷が可能** 熟知したレオロジー理論で高速印刷に耐えるペーストを実現、生産効率の向上に大きく寄与
- **短時間リフローが可能** 卓越した有機合成技術で短時間リフローを実現、生産効率の向上に大きく寄与
- **生産歩留が安定** 長年培った総合技術力が高品質を実現しており、常に高い生産歩留まりを約束します



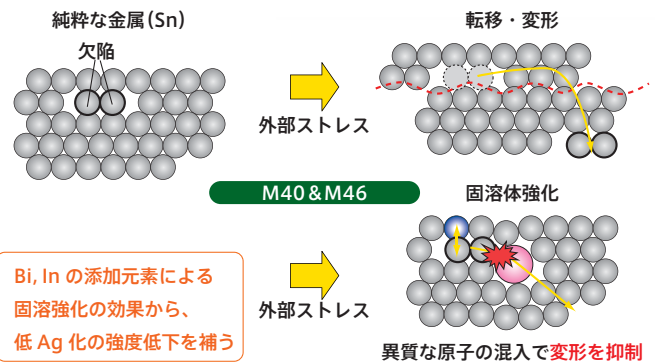
製品仕様

□ **M705と同等以上、低銀でも高品質を確保**

各種合金の耐熱疲労性比較



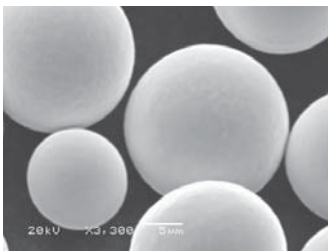
□ **固溶体強化で高品質を獲得**



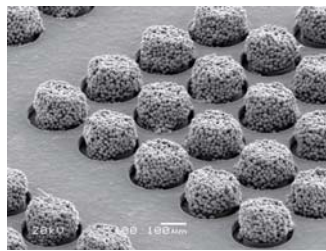
□ **高速印刷が可能なSPシリーズペースト**

高度なレオロジー技術と微細な真球パウダーが高速印刷を可能に

0.4mmPitch BGA 開口 200um / マスク厚 100um



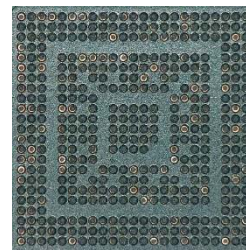
微細なパウダー



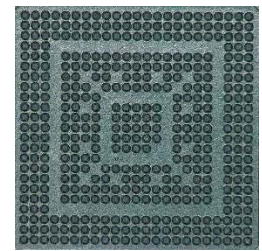
150mm/s での印刷状態

高速 (150mm/s) 印刷での転写状態

0.4mmPitch BGA 開口 200um / マスク厚 100um



従来品 (所々のドットに印刷不良)

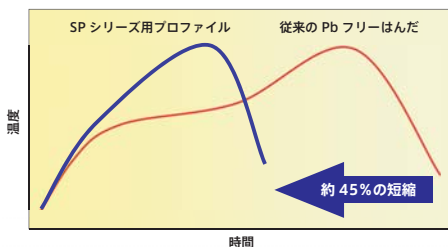


SPシリーズ (印刷不良が見られない)

□ **短時間リフローが可能なSPシリーズペースト**

卓越した有機合成技術で、短時間リフローを実現

短時間リフローでも品質は確保



Sh-Semi12-05J

充分な濡れ性を確保

チップ部品 シールドケース

充分な接合性を確保

界面合金層の生成

□ **SPシリーズで、生産タクトを約30%短縮**

リフローの短縮化で生産効率をUP

